

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年6月22日(22.06.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/112453 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/308 (2006.01) *CHD 7/26* (2006.01)

SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/038107

(22) 国際出願日: 2022年10月12日(12.10.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-205279 2021年12月17日(17.12.2021) JP

(71) 出願人: 株式会社 レゾナック (**RESONAC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目1番9号 Tokyo (JP).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者: 松井 一真 (**MATSUI Kazuma**); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目1番9号 昭和電工株式会社内 Tokyo (JP).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(74) 代理人: 田中 秀 ▲ てつ ▼, 外 (**TANAKA Hidetetsu et al.**); 〒1056032 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー32階 弁理士法人日栄国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,

(54) **Title:** METHOD FOR REMOVING LANTHANUM COMPOUND AND PROCESSING LIQUID FOR LANTHANUM COMPOUND REMOVAL

(54) 発明の名称: ランタン化合物の除去方法及びランタン化合物除去用処理液

(57) **Abstract:** The present invention provides a method for removing a lanthanum compound, the method being capable of selectively removing a lanthanum compound over materials that are not the targets of removal. This method for removing a lanthanum compound comprises a removal step in which a lanthanum compound is removed from a material to be processed containing the lanthanum compound that is the target of removal and materials that are not the targets of removal by bringing a processing liquid for lanthanum compound removal into contact with the material to be processed. The processing liquid for lanthanum compound removal is an aqueous solution that contains a salt of an α -hydroxycarboxylic acid, while having a pH of 5 to 10.

(57) 要約: 非除去対象物に比べてランタン化合物を選択的に除去することが可能なランタン化合物の除去方法を提供する。ランタン化合物の除去方法は、除去の対象であるランタン化合物と除去の対象ではない非除去対象物とを有する被処理物に、ランタン化合物除去用処理液を接触させることにより、被処理物からランタン化合物を除去する除去工程を備える。ランタン化合物除去用処理液は、 α -ヒドロキシカルボン酸の塩を含有し且つ pH が 5 以上 10 以下である水溶液である。

WO 2023/112453 A1